

平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年8月9日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社アバールデータ

コード番号 6918 URL <http://www.avaldata.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 広光 勲

問合せ先責任者 (役職名) 管理本部部長

(氏名) 大関 拓夫

TEL 042-732-1000

四半期報告書提出予定日 平成25年8月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第1四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第1四半期	1,284	△13.0	4	△94.6	34	△65.4	24	△51.2
25年3月期第1四半期	1,476	△22.6	80	△61.3	99	△58.5	49	△71.4

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 13百万円 (—%) 25年3月期第1四半期 △49百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期第1四半期	3.97	—
25年3月期第1四半期	8.23	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年3月期第1四半期	9,803	8,490	79.7
25年3月期	9,714	8,488	80.4

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 7,816百万円 25年3月期 7,811百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期	—	5.00	—	3.00	8.00
26年3月期	—	—	—	—	—
26年3月期(予想)	—	4.00	—	6.00	10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	2,600	△5.0	45	△53.0	65	△45.6	25	△57.8	4.11
通期	5,700	14.9	265	—	310	378.1	180	914.2	29.56

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 — 社 (社名) 、 除外 — 社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 有
④ 修正再表示 : 無

当社は、原価差額の配賦方法を当第1四半期連結会計期間より変更しております。当該変更に関する理由及び影響額を含め、【添付資料】4ページ「(3)追加情報」に記載しておりますのでご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	26年3月期1Q	8,064,542 株	25年3月期	8,064,542 株
② 期末自己株式数	26年3月期1Q	1,972,434 株	25年3月期	1,983,534 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期1Q	6,089,668 株	25年3月期1Q	6,013,497 株

(注)当社は、信託型従業員持株インセンティブ・プランを導入しております。当該プランにかかる従持信託が所有する当社株式数については、四半期連結財務諸表において自己株式として表示していることから、当該従持信託が所有する当社株式数については、「期末自己株式数」に、26年3月期1Qは172,000株、25年3月期は183,100株をそれぞれ含めており、「期中平均株式数(四半期累計)」から26年3月期1Qは174,440株、25年3月期に218,209株を控除しております。

なお、信託型従業員持株インセンティブ・プランの詳細については【添付資料】4ページ「(3)追加情報」に記載しております。

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】3ページ「(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
(3) 追加情報	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	7
四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9
4. 補足情報	10
(1) 生産、受注及び販売の状況	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済・金融政策などを背景に、企業業績や消費動向が改善するなど景気回復に向けた明るい兆しが見られたものの、為替や株式市場が大きく変動するなど、依然として先行き不透明な状況で推移しております。

当社グループに関連深い半導体製造装置業界におきましては、世界経済の不透明感に加え、従来型PCおよび薄型テレビの低迷、スマートフォンおよびタブレットの減速により、半導体製造装置関連の需要はいまだ本格的な回復には至っておりません。

このような経営環境のもと、当社グループは顧客満足度の更なる向上のために、市場ニーズを先取りした新製品の投入によりお客様の装置の競争力向上に貢献するとともに、省電力および生産性向上にむけた設備導入と環境に優しいモノ作りを実現、品質面では業界水準を越える品質の確保、さらに社内の業務プロセスを見直すことにより、収益性の向上に取り組みました。

この結果、第1四半期連結累計期間における売上高は1,284百万円（前年同四半期比13.0%減）、営業利益は4百万円（前年同四半期比94.6%減）、経常利益は34百万円（前年同四半期比65.4%減）、四半期純利益は24百万円（前年同四半期比51.2%減）となりました。

当社グループでは、事業内容を2つの報告セグメントに分けております。当第1四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は次のとおりであります。

① 受託製品

当該セグメントは、半導体製造装置関連、産業用制御機器および計測機器の開発・製造・販売を行っております。大手半導体メーカーの設備投資が再開されましたが、本格的な回復に至っておらず、売上高は減少しております。

この結果、売上高は807百万円（前年同四半期比11.2%減）、セグメント営業利益は49百万円（前年同四半期比60.4%減）となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 半導体製造装置関連

当該品目は、半導体製造装置の制御部を提供しております。大手半導体メーカーのLSI微細化が続く中、最先端の半導体製造装置への設備投資が再開されましたが、半導体製造装置関連製品全体の本格的な回復に至っておらず、売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は497百万円（前年同四半期比1.9%減）となりました。

ロ) 産業用制御機器

当該品目は、各種の産業用装置、社会インフラ関連の制御部を開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。産業用装置の受注は回復基調にあるものの、社会インフラ関連が引き続き低迷し、売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は124百万円（前年同四半期比27.3%減）となりました。

ハ) 計測機器

当該品目は、各種計測機器のコントローラ、通信機器の制御部を開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。主力の電力関連機器は堅調に推移しましたが、各種計測機器の受注の低迷により売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は185百万円（前年同四半期比19.6%減）となりました。

② 自社製品

当該セグメントは、組込みモジュール、画像処理モジュールおよび計測通信機器の開発・製造・販売並びにこれらに付属する周辺機器およびソフトウェア等の自社製品関連商品の販売を行っております。全般的な産業用装置における設備投資が回復基調にあることに加え、新製品の立ち上がり等により自社製品全般の受注は回復局面に転じております。

この結果、売上高は476百万円（前年同四半期比16.0%減）、セグメント営業利益は71百万円（前年同四半期比15.6%減）となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 組込みモジュール

当該品目は、半導体製造装置、FA全般、電力・通信関連向けに提供しております。FA全般および半導体製造装置関連の需要は回復局面にありますますが、売上高はわずかに減少いたしました。

この結果、売上高は112百万円（前年同四半期比1.2%減）となりました。

ロ) 画像処理モジュール

当該品目は、FA全般、各種検査装置、液晶関連機器に提供しております。新製品の立

ち上がりに加え新分野での営業開拓が順調に進みましたが、FA全般および液晶関連装置はいまだ本格的な回復には至っておりません。

この結果、売上高は121百万円（前年同四半期比28.5%減）となりました。

ハ) 計測通信機器

当該品目は、超高速シリアル通信モジュール「GiGA CHANNEL」シリーズ、FAXサーバ・コールセンター向けCTI (Computer Telephony Integration) ・リモート監視機器およびスマート電源装置を提供しております。超高速シリアル通信モジュールにおいては新製品の開拓は引続き順調に推移しましたが、一時的な需要の低迷により、売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は188百万円（前年同四半期比27.1%減）となりました。

ニ) 自社製品関連商品

当該品目は、自社製品の販売促進とシステム販売による高付加価値化を図るため、ソフトウェアおよび付属の周辺機器を提供しております。大口受注により、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は53百万円（前年同四半期比119.7%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における資産は9,803百万円（前連結会計年度末比88百万円の増加）となりました。

流動資産につきましては、主に、現金及び預金が39百万円増加、受取手形及び売掛金が123百万円増加、電子記録債権が192百万円増加、その他が主に顧客からの支払方法がファクタリングから電子記録債権へ切替ったことで未収入金が減少したこと等により240百万円減少した結果、112百万円増加し6,065百万円となりました。固定資産につきましては、主に、有形固定資産が8百万円減少、無形固定資産が3百万円減少、投資その他の資産が投資有価証券の時価変動等の影響により12百万円減少した結果、23百万円減少し3,738百万円となりました。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における負債は1,313百万円（前連結会計年度末比87百万円の増加）となりました。

流動負債につきましては、主に、原材料等の仕入増加に伴い支払手形及び買掛金が114百万円増加、賞与引当金が73百万円減少、その他が預り金、前受金及び未払費用等の増加並びに未払金の減少により54百万円増加した結果、97百万円増加し758百万円となりました。固定負債につきましては、主に、退職給付引当金が4百万円減少等した結果、10百万円減少し554百万円となりました。

なお、負債項目に記載しております、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」導入によるものであります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産は8,490百万円（前連結会計年度末比1百万円の増加）となりました。

主に、利益剰余金が5百万円増加、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」導入により自己株式が7百万円減少、その他有価証券評価差額金が8百万円減少、少数株主持分が6百万円減少したことが要因となります。

(自己資本比率)

当第1四半期連結会計期間末における自己資本比率は79.7%（前連結会計年度末比0.7ポイントの減少）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の予想につきましては、当社グループに関連の深い半導体製造装置業界の市況環境や需要環境の回復が遅れており予断を許しませんが、概ね計画通りに推移しており、現時点では、平成25年5月10日付「平成25年3月期 決算短信」に公表いたしました数値からの変更はございません。

また今後、当社グループを取り巻く環境が著しく変化した場合等、業績に影響を及ぼす事態が生じた場合には速やかに適時開示を行います。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はございません。

- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
（原価差額の配賦方法の変更）

当社は、原価差額の配賦方法を当第1四半期連結会計期間より変更しております。当該変更に関する理由及び影響額を含め、(3) 追加情報にて記載しております。

- (3) 追加情報

（信託型従業員持株インセンティブ・プランの会計処理について）

当社は、平成23年5月25日開催の取締役会において、当社グループ従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）」（以下「本プラン」といいます。）の導入を決議いたしました。

割当先である野村信託銀行株式会社「アパールグループ社員持株会専用信託口」（以下「従持信託」といいます。）は、当社と野村信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、野村信託銀行株式会社を受託者とする金銭信託契約（以下「本信託契約」といい、本信託契約によって設定される信託を「本信託」といいます。）を締結することによって設定された信託口であります。

本プランでは、従持信託が、本信託の設定後6年間にわたりアパールグループ社員持株会（以下「本持株会」といいます。）が取得すると合理的に見込まれる数の株式会社アパールデータ株式を、金融機関からの借入金を原資として、当社からの第三者割当によって取得します。当該借入は、貸付人を株式会社横浜銀行、借入人を従持信託、保証人を当社とする三者間で締結される責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づいて行われます。

従持信託が取得した当社株式は、本持株会と締結される株式注文契約に基づき、信託期間（6年）において、毎月、その時々々の時価で売却いたします。

本信託では、当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を借入金の返済及び金利の支払いに充当いたします。本信託の終了後、本信託の信託財産に属する金銭から、本信託に係る信託費用や未払いの借入元利金などを支払い、残余の財産が存在する場合は、当該金銭を、本信託契約で定める受益者適格要件を満たす従業員等に分配いたします。なお、当社は従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落等により本信託の終了時点において借入金が完済できない場合は、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき保証人である当社が保証履行いたします。

当社は平成23年6月22日付で、自己株式312,400株を従持信託へ譲渡しております。当該自己株式については、当社から従持信託へ株式を譲渡した時点で売却処理を行っております。また、従持信託が所有する株式を含む資産及び負債ならびに費用及び収益については、当社と従持信託は一体であるとし、当社の四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書に含めて処理しております。なお、従持信託が所有する株式については自己株式として表示しており、当第1四半期連結会計期間末において、従持信託が所有する当社株式数は、172,000株となっております。

（原価差額の配賦方法の変更について）

当社は従来より、発生した原価差額については一括して売上原価、たな卸資産等にそれぞれの計上金額の割合に応じて配賦しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より原価差額をその発生部門の構成ごとに分け、対応する売上原価、たな卸資産等にそれぞれの計上金額の割合に応じて配賦しております。この変更は、当社を取り巻く状況の変化に対応し、社内の原価管理体制を見直すことを契機に、発生した原価差額の影響を適切に財政状態及び経営成績に反映させるために行ったものであります。

これにより、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書は売上原価が9,131千円増加したことにより、売上総利益が同額減少し、研究開発費（販売費及び一般管理費）が10,699千円減少したことにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ1,568千円増加しております。また、当第1四半期連結会計期間の四半期連結貸借対照表は商品及び製品が4,227千円増加し、仕掛品が2,658千円減少しております。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,245,246	3,284,861
受取手形及び売掛金	873,827	997,592
電子記録債権	86,983	279,713
有価証券	40,491	40,388
商品及び製品	357,602	310,222
仕掛品	227,165	230,729
原材料及び貯蔵品	567,503	608,895
その他	553,675	312,759
流動資産合計	5,952,496	6,065,161
固定資産		
有形固定資産		
土地	1,316,699	1,316,699
その他(純額)	895,063	887,004
有形固定資産合計	2,211,763	2,203,704
無形固定資産	76,126	72,933
投資その他の資産		
投資有価証券	1,404,881	1,392,553
その他	99,308	99,003
貸倒引当金	△29,916	△29,886
投資その他の資産合計	1,474,273	1,461,670
固定資産合計	3,762,163	3,738,307
資産合計	9,714,660	9,803,468
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	319,810	434,671
1年内返済予定の長期借入金	32,000	32,000
賞与引当金	174,055	100,310
役員賞与引当金	—	1,644
その他	135,578	190,255
流動負債合計	661,443	758,881
固定負債		
長期借入金	103,910	103,910
退職給付引当金	107,142	103,064
役員退職慰労引当金	70,672	67,502
その他	282,678	279,733
固定負債合計	564,403	554,209
負債合計	1,225,846	1,313,091

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,354,094	2,354,094
資本剰余金	2,446,534	2,446,534
利益剰余金	3,752,649	3,758,040
自己株式	△1,328,411	△1,321,285
株主資本合計	7,224,867	7,237,384
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	586,881	578,875
その他の包括利益累計額合計	586,881	578,875
新株予約権	8,151	11,208
少数株主持分	668,913	662,908
純資産合計	8,488,813	8,490,377
負債純資産合計	9,714,660	9,803,468

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
売上高	1,476,944	1,284,418
売上原価	966,679	894,807
売上総利益	510,265	389,611
販売費及び一般管理費	429,991	385,316
営業利益	80,273	4,295
営業外収益		
受取利息	271	287
受取配当金	14,830	22,750
その他	4,084	7,222
営業外収益合計	19,187	30,261
営業外費用		
支払利息	311	223
為替差損	0	—
支払手数料	32	46
営業外費用合計	344	270
経常利益	99,115	34,285
特別損失		
固定資産除却損	6	141
投資有価証券評価損	10,220	—
特別損失合計	10,226	141
税金等調整前四半期純利益	88,889	34,144
法人税、住民税及び事業税	11,102	2,368
法人税等調整額	21,904	9,846
法人税等合計	33,006	12,215
少数株主損益調整前四半期純利益	55,882	21,928
少数株主利益又は少数株主損失(△)	6,373	△2,254
四半期純利益	49,508	24,183

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	55,882	21,928
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△105,829	△8,005
その他の包括利益合計	△105,829	△8,005
四半期包括利益	△49,947	13,923
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△56,320	16,177
少数株主に係る四半期包括利益	6,373	△2,254

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年6月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	受託製品	自社製品	合計
売上高			
外部顧客への売上高	909,114	567,829	1,476,944
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	909,114	567,829	1,476,944
セグメント利益	124,223	84,123	208,347

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	208,347
セグメント間取引消去	—
全社費用(注)	△128,073
四半期連結損益計算書の営業利益	80,273

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年6月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	受託製品	自社製品	合計
売上高			
外部顧客への売上高	807,703	476,715	1,284,418
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	807,703	476,715	1,284,418
セグメント利益	49,167	71,040	120,207

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利 益	金 額
報告セグメント計	120,207
セグメント間取引消去	—
全社費用（注）	△115,912
四半期連結損益計算書の営業利益	4,295

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	363,644	△49.7	344,038	△5.4
産業用制御機器	127,176	3.7	94,883	△25.4
計測機器	167,573	20.0	161,891	△3.4
小計	658,394	△33.2	600,813	△8.7
自社製品				
組込みモジュール	73,281	△34.0	68,963	△5.9
画像処理モジュール	75,912	△8.8	48,351	△36.3
計測通信機器	112,734	56.1	81,810	△27.4
小計	261,928	△1.7	199,126	△24.0
合計	920,322	△26.5	799,939	△13.1

(注) 1 金額は製造原価にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3 自社製品セグメントにおいては、記載した詳細品目に付属する周辺機器の提供として、自社製品関連商品の販売を行っておりますが、当該仕入実績は、② 商品仕入実績として別途記載しております。

② 商品仕入実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
自社製品				
自社製品関連商品	30,701	△13.6	47,488	54.7
合計	30,701	△13.6	47,488	54.7

(注) 1 金額は仕入価格にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

③ 受注状況及び販売状況

イ) 受注高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	448,733	△46.7	559,931	24.8
産業用制御機器	181,287	△20.3	161,456	△10.9
計測機器	201,522	△2.2	203,202	0.8
小計	831,542	△34.8	924,590	11.2
合計	831,542	△34.8	924,590	11.2

ロ) 受注残高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	159,975	△51.9	257,244	60.8
産業用制御機器	181,791	△13.2	159,120	△12.5
計測機器	202,584	14.3	160,680	△20.7
小計	544,352	△24.3	577,046	6.0
合計	544,352	△24.3	577,046	6.0

ハ) 販売実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	507,470	△48.1	497,886	△1.9
産業用制御機器	170,850	△2.5	124,232	△27.3
計測機器	230,793	31.1	185,584	△19.6
小計	909,114	△31.6	807,703	△11.2
自社製品				
組込みモジュール	113,901	△41.0	112,498	△1.2
画像処理モジュール	170,182	△5.6	121,684	△28.5
計測通信機器	259,357	61.2	188,952	△27.1
自社製品関連商品	24,388	△45.1	53,579	119.7
小計	567,829	△1.9	476,715	△16.0
合計	1,476,944	△22.6	1,284,418	△13.0

(注) 1 金額は販売価格にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3 受注高及び受注残高は受託製品セグメントの内容であり、自社製品セグメントにおいては、需要予測に基づく見込生産を行っているため、該当事項はありません。